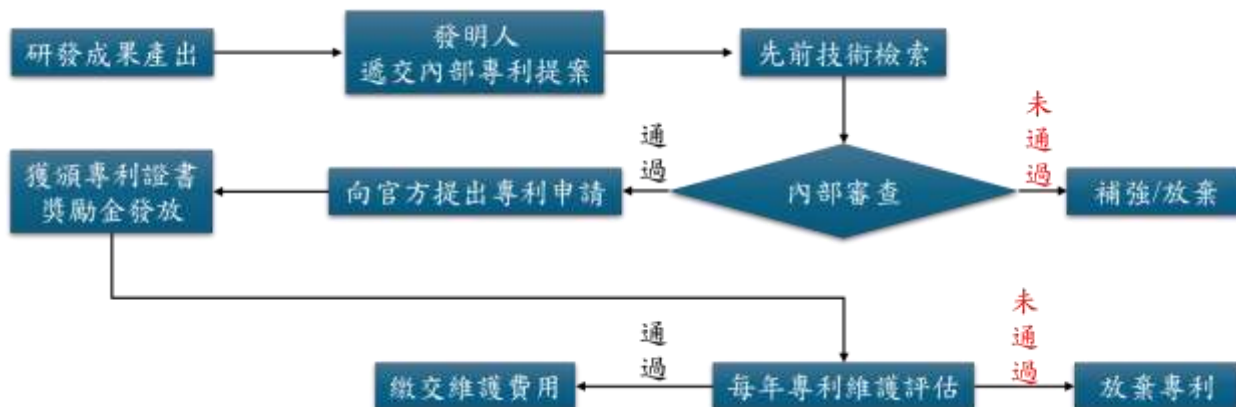


#### 4.1.4 智慧財產保護與專利佈局

##### ■ 智慧財產管理政策

1. 目標：配合公司營運及發展，同步落實其無形資產之保護。
2. 智慧財產之取得：透過專利保護自有技術，同時輔以商標建立品牌識別性。
3. 內部整合：建立專利管理辦法，整合內部資源並有效產出專利；透過獎勵制度，鼓勵並回饋同仁於無形資產之貢獻。
4. 風險管理及改善：定期監控同業專利並採取因應措施，定期追蹤智慧財產權現況並研擬改善方向。

##### ■ 專利申請及維護流程



##### ■ 近兩年專利數量統計

項目	2023 年	2024 年
當年專利申請數量	35	22
當年專利取得數量	21	18
累計曾取得專利數量	366	384
當年重要專利簡介	具封裝結構之過電流保護元件	導線架型式之導熱元件

2023 年度取得的過電流保護元件專利，包含封裝層的設計。本發明調整過電流保護元件的焊墊位置，使得封膠得以達最大覆蓋率同時又不致因沾附電極或溢膠而影響其電氣表現。如此一來，過電流保護元件可受到封裝層的保護，免於受外界影響而出現特性衰退或電阻值不穩定的問題。